

PICOSUN™ R-200高級型

PICOSUN™ R-200高級ALD系統適用於IC元件、MEMS元件、顯示器、LED、雷射及鏡片、光學器件、珠寶、硬幣和醫療植入器械等3D物件等的研發。

頂級ALD系統滿足應用需求

PICOSUN™ R-200高級ALD系統是全球市場上的高級ALD研究工具引領者，擁有上百客戶。它已成為創新型公司和研究機構的首選。

該系統設計靈活，確保沉積ALD薄膜的高品質，同時超級靈活的系統配置能滿足未來各種需求和應用。經專利註冊的熱腔壁設計、完全獨立的前驅物管線和顯示使得無顆粒沉積廣泛應用於晶片、3D物件和所有奈米尺度的材料。即使在最具挑戰性的多孔材料、超高深寬比和奈米顆粒表面沉積，系統都能實現極好的均勻性，這些都歸功於我們的專利技術Picoflow™。該系統配備功能強大和易於更換的液態、氣態和固態前驅物。同時，具備高效率和遠端電漿專利技術，可以沉積金屬而無短路和電漿損傷風險。系統可整合手套箱、UHV系統、手動或半自動裝載器、集群系統、粉末反應腔、卷對卷反應腔和各種即時分析系統，讓您的研究變得高效靈活，取得良好成果，不管是當下或未來研究領域發生何種變化都能勝任！

技術特徵

典型基板尺寸和類型

- 50到200 mm單片
- 156 mm x 156 mm太陽能矽晶片
- 3D物件
- 粉末和顆粒
- 小批量
- 多孔、穿孔和高深寬比（最高達1:2500）基板

製程溫度

- 50到500°C；電漿450°C（650 °C，需使用定製加熱盤）

典型製程

- Al₂O₃、TiO₂、SiO₂、Ta₂O₅、HfO₂、ZnO、ZrO₂、AlN、TiN和Pt或Ir等金屬

基板裝載

- 用氣動升降機手動裝載
- 帶磁機械臂的裝載鎖定室
- 用操作機器人進行半自動裝載
- 用集群工具進行盒對盒式裝載

前驅物

- 液態、固態、氣態、臭氧和電漿
- 6根獨立前驅物管線（如選用電漿，共7根獨立前驅物管線），最多載入12個前驅物

選配

- 集群工具、PICOFLOW™擴散增強器、卷對卷反應腔、RGA、UHV相容、N₂產生器、尾氣處理器、定製設計及手套箱整合（用於惰性氣體裝載）

如欲瞭解更多資訊或報價，請隨時聯繫我們。

picosun
AGILE ALD

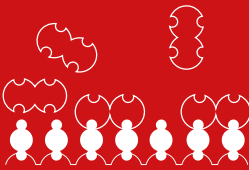
ALD的原理



引入含A元素的分子。



表面吸附分子。



引入含B元素的分子，
與表面的A元素反應。



形成AB化合物單分子層。

重複該過程，直至薄膜厚度符合預期。

picosun
AGILE ALD

PICOSUN總部

Picosun公司

地址：Tietotie 3

FI-02150 Espoo, Finland

電話：+358 50 321 1955

電子郵件：info@picosun.com

Picosun公司

地址：Masalantie 365

FI-02430 Masala, Finland

電話：+358 50 321 1955

電子郵件：info@picosun.com

PICOSUN分公司

Picosun（歐洲）有限責任公司

電話：+49 1522 449 49 11

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（美國）有限責任公司

電話：+1 214 790 0844

手機：+1 214 490 3951

電子郵件：sales@picosun.com

新加坡Picosun（亞洲）有限公司

電話：+65 9756 3265

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（臺灣）有限公司

電話：+886 90 515 2985

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（中國）有限公司

電話：+358 40 480 3449

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（日本）有限公司

電話：+81 3 6431 9500

手機：+81 90 5198 8131

電子郵件：sales@picosun.com